

# 自動加熱油圧プレス 75T 500×500Mm 定盤 プログラム可能温度・圧力ランプ 水冷式

商品番号: XP60



## 前書き

実験室およびパイロットスケールの用途に最適なこの75トン自動加熱プレスは、500×500mmの大型定盤、プログラム可能なランプを備えたデュアル独立PID温度制御、閉ループ圧力プロファイリング、急速冷却用の水冷チャンネルを内蔵しています。今すぐ見積もりをご依頼ください。

## 詳細を学ぶ

用途	説明	主な利点
炭素繊維複合材成形	炭素繊維またはガラス繊維強化熱可塑性・熱硬化性プリプレグを高温高压で固結化し、航空宇宙、自動車、スポーツ用品向けの軽量構造パネル、プレート、部品に加工します。	500×500mmの全面積にわたる均一な圧力と温度によりボイドが排除され、一貫した繊維含浸と機械的特性が確保されます。
多層PCB・CCL積層	多層プリント配線板、銅張積層板、フレキシブル回路を、多段階の温度・圧力プロファイルを用いて精密に熱プレスし、信頼性の高い層間接合を実現します。	プログラム可能なランプ制御により熱衝撃が最小化され、層間剥離、反り、樹脂のはみ出しを防ぎ、信頼性の高い基板が得られます。
固体電池電解質・電極プレス	セラミックまたはポリマー固体電解質層および複合電極を熱プレスし、全固体電池に必要な高密度化と密着した界面接触を実現します。	閉ループ圧力プロファイリングと均一加熱により、イオン伝導性と機械的完全性が向上した緻密で欠陥のない電解質テープが確保されます。
燃料電池MEA製造	PEM燃料電池向けに、制御された熱と圧力の下で触媒被覆膜とガス拡散層を接合し、膜電極接合体（MEA）を製造します。	繊細な力制御と正確な温度均一性により膜の損傷を防ぎつつ、最適な触媒層の接着と性能が得られます。
半導体ウェーハ接合	MEMS、センサー、3Dインテグレーション、先進パッケージング向けに、半導体ウェーハまたはデバイス基板を熱圧着接合します。多くの場合、熱膨張の正確なアライメントが必要とされます。	プログラム可能なランプと定盤全体での±1°Cの温度安定性により、熱ミスマッチ応力が最小化され、均一な接合品質が確保されます。
ポリマーフィルム・シート生産	熱可塑性フィルム、シート、積層板の圧縮成形および平坦化を行い、光学フィルム、包装材料、研究用試料の試料調製または小規模生産を行います。	高圧性能と急速水冷により短いサイクル時間が可能になり、制御された厚さの平坦で応力除去されたフィルムが製造されます。
複合材料試験用試料調製	ASTM/ISO規格に準拠して、複合積層板または接合継手から標準試験片を調製し、機械試験における再現性の高い試料品質を確保します。	自動化されたプログラム可能サイクルにより一貫した試料調製が実現され、ばらつきが削減され試験データの信頼性が向上します。
医薬品錠剤圧縮研究開発	加熱ダイを使用して医薬品粉末を小ロットで熱圧縮し、熱活性化が必要な製剤の評価や、速崩壊錠の製造を行います。	急速冷却を備えたプログラム可能な圧力・温度プロファイルにより、錠剤の硬度、多孔性、溶解特性を正確に制御できます。

パラメータ	仕様
モデル	XP60
最大圧力	75トン (750 kN) - 自動油圧システム
圧力制御	ランプ付きプログラム可能 (閉ループ自動)
定盤作動温度	0 - 300 °C
加熱制御	定盤独立加熱、ランプ付きPIDプログラム制御。多段温度プロファイルに対応

パラメータ	仕様
定盤サイズ	500 × 500 mm
定盤開き	100 mm
加熱出力	約 10 kW (高出力デュアルゾーン加熱)
冷却方式	循環水冷式 (外部チラーが必要)
電源	AC 380V/50Hz または AC 208V/240V/480V 三相 60Hz (必要に応じて米国市場向けにカスタマイズ可能)
装置寸法	約 680 × 680 × 1280 mm (産業用縦型高剛性フレーム)
正味重量	約 1130 kg (重量物のため、専用フォークリフトによる荷下ろしが必要です)